

## レーザー描画装置



レーザー描画装置  
Heidelberg Instruments  
DWL66FS-S

平成21年度導入

【主な用途・仕様】

レーザー光によるフォトマスクやウェハへの描画

- ・ 最小線幅：1 $\mu$ m
- ・ レーザー波長：405nm
- ・ エッジ粗さ：0.08 $\mu$ m
- ・ 線幅の再現性：0.1 $\mu$ m
- ・ アライメント精度：0.25 $\mu$ m
- ・ 描画速度：50mm<sup>2</sup>/min
- ・ 最大描画エリア：200mm×200mm

【設備使用】

レーザー描画装置

【委託分析試験】

マイクロマシニング加工 (B)